

研究評価委員会  
「次世代素材等レーザー加工技術開発プロジェクト」  
(事後評価) 分科会

日 時 : 平成27年8月20日 (木) 10:10~17:25

場 所 : WTC コンファレンスセンター Room A

〒105-6103 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル 3F

議事次第

【公開セッション】

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. 開会、資料の確認                           | 10:10~10:15 (5分)  |
| 2. 分科会の設置について                         | 10:15~10:20 (5分)  |
| 3. 分科会の公開について                         | 10:20~10:25 (5分)  |
| 4. 評価の実施方法                            | 10:25~10:40 (15分) |
| 5. プロジェクトの概要説明                        |                   |
| 5.1 「事業の位置づけ・必要性」及び「研究開発マネジメント」       |                   |
| 5.2 「研究開発成果」及び「実用化に向けての見通し<br>及び取り組み」 | 10:40~11:25 (45分) |
| 5.3 質疑                                | 11:25~12:00 (35分) |

(昼食・休憩 50分)

【非公開セッション】

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明                        |                    |
| 6.1 CFRP 切断加工技術の開発                    | 12:50~15:05 (135分) |
| 6.1.1 高出力半導体レーザー開発 (浜松ホトニクス)          | (説明 15分)           |
| 6.1.2 QCW ファイバーレーザー開発 (古河電工)          | (説明 15分)           |
| 6.1.3 パルスレーザー増幅 (ブースター) 技術の開発 (レーザー研) | (説明 20分)           |
| 質疑                                    | (30分)              |
| 6.1.4 CFRP レーザー加工技術と評価技術の開発 (産総研)     | (説明 20分)           |
| 6.1.5 パルスレーザー開発と CFRP 切断機構の解明 (接合研)   | (説明 15分)           |
| 質疑                                    | (20分)              |
|                                       | (休憩 15分)           |
| 6.2 大面積表面処理技術の開発                      | 15:20~16:10 (50分)  |
| 6.2.1 アニール用グリーンレーザー開発 (浜松ホトニクス)       | (説明 15分)           |
| 6.2.2 大面積表面処理システム開発 (アルバック)           | (説明 15分)           |
| 質疑                                    | (20分)              |
| 6.3 粉末成形技術の開発                         | 16:10~16:40 (30分)  |
| 6.3.1 粉末成形システム開発 (アスペクト)              | (説明 15分)           |
| 質疑                                    | (15分)              |

7. 全体を通しての質疑

16:40～17:00 (20分)

(入替・休憩 5分)

**【公開セッション】**

8. まとめ・講評

17:05～17:20 (15分)

9. 今後の予定、その他

17:20～17:25 (5分)

10. 閉会

17:25